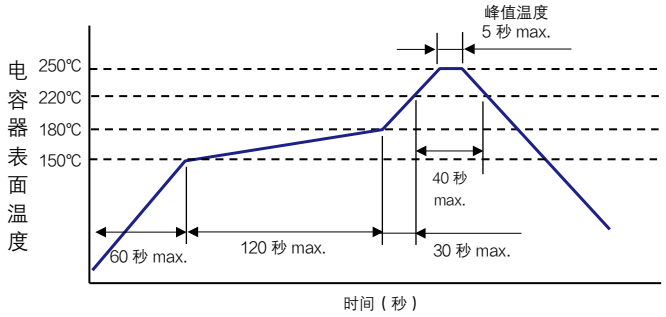
贴装规格

◇ 锡焊推荐条件

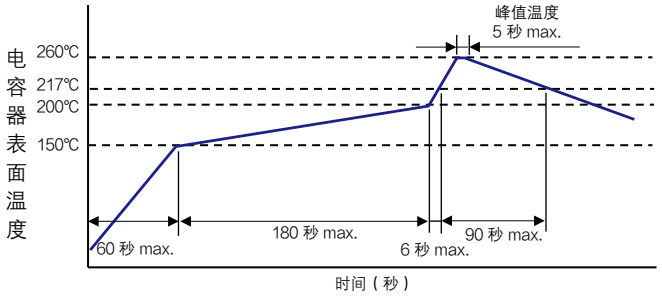
■ 对象系列：TPS, TPSF, TPE, TPF, TA
TV, TH, TPB, TC, TPC

峰值温度250 ℃　无铅回流焊
回流焊在下述回流焊条件下至多2次。



■ 对象系列：TPS, TPSF, TPE, TPF, TA
TV, TPB, TC, TPC

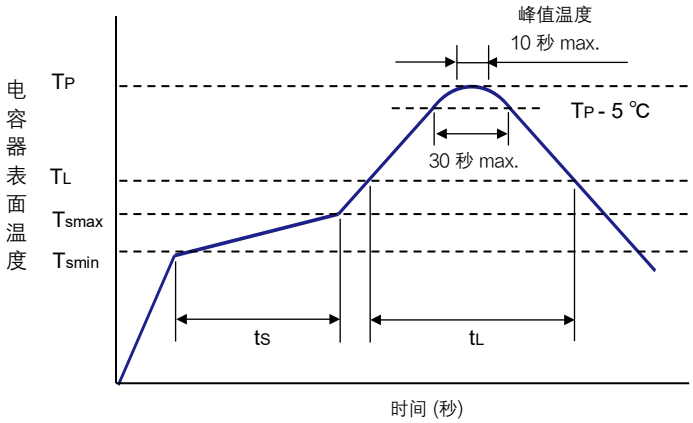
峰值温度260 ℃　无铅回流焊
回流焊在下述回流焊条件下至多2次。



注)该回流焊条件在吸湿水平上有限制。
有关详情，请另行向本公司咨询。

■ 对象系列：TQC, TDC, TQS, TQT

* 有关兼容部件号，请参见各系列特性列表。

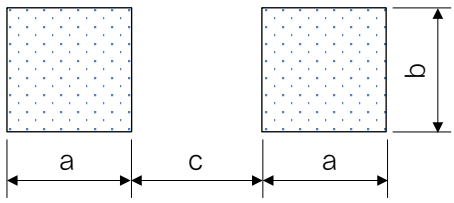


锡焊条件		条件A	条件B	条件C	条件D
		IPC/J-STD-020 回流		峰值温度 250 ℃无铅回流焊	
峰值温度 (TP)		260 ℃	250 ℃	250 ℃	
峰值温度 -5 ℃以内の時間		30 秒 max.		–	
主加热温度 (TL)和时间 (tL)	TL ≧ 217 ℃	150 秒 max.		90 秒 max.	60 秒 max.
	TL ≧ 200 ℃	–			70 秒 max.
预热	最高温度 (Tsmax)	200 ℃		180 ℃	
	最低温度 (Tsmin)	150 ℃			
	时间 (ts)	120 秒 max.			
回流次数		3次以内		2次以内	

● 使用钎焊烙铁的锡焊

烙铁头温度 ：350 ℃以下 (TQC / TDC / TQS / TQT 系列400 ℃以下)
作业时间　 ：3 秒以内 (TQC / TQS / TQT 系列5 秒以内)
(但是，切勿用烙铁头触碰电容器本体或对其施加强力。)

焊盘尺寸



单位：mm

尺寸代码	a	b	c
B1, B1S, B2, B2S	1.6	2.7	1.4
D15, D2E, D2, D3L, D4	2.4	2.9	3.7
D15S	1.4 / 1.7 *1	2.6	4.6
D2S	1.4	2.6	5.1

*1：+側 / 一側